

# John W. Balde (1923-2003)



Pays : **États-Unis**

Langue : **Anglais**

Sexe : **Masculin**

Naissance : **New York, N. Y., 04-03-1923**

Mort : **Flemington, N. J., 08-09-2003**

Note : **Ingénieur. - En poste : Interconnection decision consulting, Flemington, N. J. (en 2003)**

Autre forme du nom : **Jack Balde**

ISNI : **ISNI 0000 0001 0856 1847 (Informations sur l'ISNI)**

**John W. Balde (1923-2003) : œuvres (1 ressource dans data.bnf.fr)**

## Œuvres textuelles (1)

"Foldable flex and thinned silicon multichip packaging   
technology"  
(2003)

*avec John W. Balde (1923-2003) comme Éditeur scientifique*

**Thèmes en relation avec John W. Balde (1923-2003)** (3 ressources dans data.bnf.fr)

**Autres (3)**

Circuits imprimés souples



Mise sous boîtier (microélectronique)



Modules multipuces (microélectronique)



**Personnes ou collectivités en relation avec "John W. Balde (1923-2003)"** (1 ressources dans data.bnf.fr)

**Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1)**

International microelectronic and packaging society



**Voir aussi** (3 ressources dans data.bnf.fr)

**À la BnF (1)**

Notice correspondante dans Catalogue général

**Sur le Web (2)**

Notice correspondante dans ISNI

Notice correspondante dans VIAF